

下線申請網頁說明及注意事項

一、如何進入下線申請網頁：

Step1：請至中心官網，點選**晶片製作**→**晶片下線**→**下線申請**。

TSRI 國家實驗研究院
台灣半導體研究中心
Taiwan Semiconductor Research Institute

關於中心 會員服務 設計服務 晶片製作 製程服務 量測服務 教育訓練 技術推廣 國際合作 資訊公開

晶片下線
服務說明
下線時程
下線導引
下線申請
測試報告
加總積點
常見問題
下線簽認
自費封裝/細切
聯絡窗口
收費標準

製程/矽智財使用
製程/矽智財簡介
製程/矽智財申請
技術資料下載
資安宣導線上評估
SL使用說明

PCB/IPD/晶晶製作
PCB製程/時程/窗口
PCB軟體/技術資料
PCB計費方式
PCB製作申請
PCB申請後作業
IPD基板製作
自費晶晶組裝製作

其他
設計檔案匯出

先點選**晶片製作**，展開選單後，請選：**晶片下線**→**下線申請**

Step 2：若您尚未登入，請先登入會員。

TSRI 國家實驗研究院
台灣半導體研究中心
Taiwan Semiconductor Research Institute

會員服務平台 - 系統登入

使用者名稱
請輸入會員帳號或email

密碼
password

請輸入驗證碼

忘記帳號 / 忘記密碼

登入

還未註冊? 創立一個帳號吧!

常見問題 聯絡我們

請輸入您在本中心的會員帳號及密碼，並輸入驗證碼後，再按**登入**

Step 3：系統為您導引至下線申請網頁主頁。

學生-您好,歡迎您再次登入 (登出)

 **NAR Labs** 國家實驗研究院
台灣半導體研究中心
Taiwan Semiconductor Research Institute

EN   輸入關鍵字

國研院 | 聯絡我們 | 製程設備狀況   

晶片製作申請系統

您好，歡迎使用國家實驗研究院台灣半導體研究中心晶片製作申請系統，在您開始進行申請之前，請先詳閱下列表格與備註說明，確認您具備即將選取晶片種類之申請資格：

(1) 表格前三行（製程權限、成績計分點名單、教授智財權切結書）內之星號表示在您申請某一製程前必須先完成的步驟，舉例來說，在您申請教育性晶片製作前，您的授課教師需要完成製程權限申請，您需要獲得教師授權使用製程，並且授課教師需將課程的成績計分點名單與智財權切結書寄往本中心業務窗口完成資料庫輸入處理。

(2) 最後一行“測試報告”內的星號表示在您收到晶片後，需要在時限內完成晶片測試報告的上傳，除了自費晶片外，另四類晶片均需申請人於收到晶片後上傳晶片測試報告。

其他說明請參見備註，若您確認申請資格完備，請按本頁面最下方的「進行下線新申請」按鈕開始進行申請！

晶片種類	製程權限	成績計分點名單	教授智財權切結書	測試報告	其它
前瞻速審部分負擔	★	--	★	★	
前瞻部分負擔	★	--	★	★	
教育性晶片	★	★	★	★	
新進教師優惠	★	--	★	★	新進教師優惠證明文件
優良晶片優惠	★	--	★	★	
自費晶片	★	--	--	--	

備註:

- 製程權限:申請者的指導教授需具備有效之製程權限(教育性晶片:授課教授需具備有效之製程權限);申請者則必須有教授核可使用製程權限。
- 自費晶片申請者本人需具備有效之製程權限,或是出具合法使用製程資料聲明。
- 成績計分點名單為授課教授需事先提供給本中心的資料;請名單中的學生於有效申請期間內申請教育性晶片。
- 測試報告:
 - 申請者名下無論是哪種類型晶片,若累積有一篇(含)以上逾期未繳的測試報告,即不可做新案申請。
 - 前瞻性晶片(含前瞻部分負擔、前瞻速審部分負擔、新進教師優惠、優良晶片優惠):若指導教授及其名下學生累積超過三篇以上此類型晶片逾期未繳的測試報告,則指導教授及其名下學生皆不可做新案申請。
 - 教育性晶片:若授課教授及其授課學生累積超過六篇以上此類型晶片逾期未繳的測試報告,則授課教授及其授課學生皆不可做新案申請。
 - 測試報告上傳完成後,繳交狀態為:已上傳,即可做新案申請。
- 新進教師優惠:請教授事先提供新進教師優惠證明文件給本中心確認及建檔,教授/學生方能申請此類型晶片;請留意,此類型的晶片,核可後將有一定額度與顆數可免費下線的晶片,倘已超過顆數或額度,皆無法做新案申請。
- 優良晶片優惠:此類型的晶片資料由本中心整理與建檔,資料輸入系統後教授/學生方能申請此類型晶片;請留意,此類型的晶片有一定額度與顆數免費與免審查之晶片,倘已超過顆數或額度,皆無法做新案申請。
- 若有任何有關下線申請的問題,請參考[下線導引](#)。

[檢視申請總表](#) [進行下線新申請](#) [下載使用操作手冊](#)

相關連結

- 下線新申請
- 檢視下線資格
- 下線申請總表
- 下線時程列表
- 下線歷史資料
- 申請說明手冊
- 申請流程圖
- 下線認證
- 費用查詢
- 下線導引
- 測試報告
- 製程申請
- 常見問題
- 連絡窗口
- 查系統下線資料
- 回到本中心首頁

聯絡我們

新竹辦公室： 300091 新竹市科學園區農業一路26號

TEL 03-5773693

FAX 03-5713403

台南-成大奇美樓： 701301 台南市大學路1號成功大學自強校區奇美樓7樓

TEL 06-2087971

FAX 06-2089122

台南-科學園區： 744094 台南市新市區南科三路27號

TEL 06-5050650

FAX 06-5050553

最佳瀏覽解析度為1366*768以上

專業認證



二、下線申請步驟Step by Step：

Step 0：請先閱覽下線申請網頁上的各項說明，確認您是否具備下線資格(可點選右側的相關連結→[檢視下線資格查詢自己的相關資格說明](#))，再點選 " 進行下線新申請 " 按鈕開始申請：

晶片製作申請系統

您好，歡迎使用國家實驗研究院台灣半導體研究中心晶片製作申請系統，在您開始進行申請之前，請先詳閱下列表格與備註說明，確認您具備即將選取晶片種類之申請資格：

(1) 表格前三行 (製程權限、成績計分點名單、教授智財權切結書) 內之星號表示在您申請某一製程前必須先完成的步驟，舉例來說，在您申請教育性晶片製作前，您的授課教師需要完成製程權限申請，您需要獲得教師授權使用製程，並且授課教師需將課程的成績計分點名單與智財權切結書寄往本中心業務窗口完成資料庫輸入處理。

(2) 最後一行"測試報告"內之星號表示在您收到晶片後，需要在時限內完成晶片測試報告的上傳，除了自費晶片外，另四類晶片均需申請人於收到晶片後上傳晶片測試報告。

其他說明請參見備註，若您確認申請資格完備，請按本頁面最下方的「進行下線新申請」按鈕開始進行申請！

晶片種類	製程權限	成績計分點名單	教授智財權切結書	測試報告	其它
前瞻速審部分負擔	★	--	★	★	
前瞻部分負擔	★	--	★	★	
教育性晶片	★	★	★	★	
新進教師優惠	★	--	★	★	新進教師優惠證明文件
優良晶片優惠	★	--	★	★	
自費晶片	★	--	--	--	

備註：

- 製程權限:申請者的指導教授需具備有效之製程權限(教育性晶片:授課教授需具備有效之製程權限);申請者則必須有教授核可使用製程權限。
- 自費晶片申請者本人需具備有效之製程權限,或是出具合法使用製程資料聲明。
- 成績計分點名單為授課教授需事先提供給本中心的資料;請名單中的學生於有效申請期間內申請教育性晶片。
- 測試報告:
 - 申請者名下無論是哪種類型晶片,若累積有一篇(含)以上逾期未繳的測試報告,即不可做新案申請。
 - 前瞻性晶片(含前瞻部分負擔、前瞻速審部分負擔、新進教師優惠、優良晶片優惠):若指導教授及其名下學生累積超過三篇以上此類型晶片逾期未繳的測試報告,則指導教授及其名下學生皆不可做新案申請。
 - 教育性晶片:若授課教授及其授課學生累積超過六篇以上此類型晶片逾期未繳的測試報告,則授課教授及其授課學生皆不可做新案申請。
 - 測試報告上傳完成後,繳交狀態為:已上傳,即可做新案申請。
- 新進教師優惠:請教授事先提供新進教師優惠證明文件給本中心確認及建檔,教授/學生方能申請此類型晶片;請留意,此類型的晶片,核可後將有一定額度與顆數可免費下線的晶片,倘已超過顆數或額度,皆無法做新案申請。
- 優良晶片優惠:此類型的晶片資料由本中心整理與建檔,資料輸入系統後教授/學生方能申請此類型晶片;請留意,此類型的晶片有一定額度與顆數免費與免審查之晶片,倘已超過顆數或額度,皆無法做新案申請。
- 若有任何有關下線申請的問題,請參考[下線導引](#)。

檢視申請總表 **進行下線新申請** [下載使用操作手冊](#)

請點選進行下線新申請

相關連結

- [下線新申請](#)
- [檢視下線資格](#)
- [下線申請總表](#)
- [下線時程列表](#)
- [下線歷史資料](#)
- [申請說明手冊](#)
- [申請流程圖](#)
- [下線簽認](#)
- [費用查詢](#)
- [下線導引](#)
- [測試報告](#)
- [製程申請](#)
- [常見問題](#)
- [連絡窗口](#)
- [舊系統下線資料](#)
- [回到本中心首頁](#)

Step 1：下線新申請：請選擇申請製程、梯次、種類。

STEP 1：下線新申請 → STEP 2 → STEP 3 → STEP 4 → STEP 5 → STEP 6

★請在「[下線時程列表](#)」的各梯次「[開放申請日](#)」和「[申請截止日](#)」之期間上網登錄申請，其餘時間不開放晶片製作申請。

請選取您要申請下線的梯次與種類：

目前開放申請之梯次與晶片種類：

搭配整合製程：

◎注意，若無符合資格的晶片種類，將不會出現在選項

說明：

- 若無教育性晶片種類可以選擇，表示申請者之教授未繳交成績計分點名單與Excel檔，請參考下線導引網頁 -> 下線申請前作業-請預先繳交相關資料 -> 成績計分點名單與Excel檔 進行繳交
- 若您對申請之優惠晶片種類有疑問，請先向指導教授詢問採用何種優惠。(例如，若指導教授欲使用優良晶片/新進教師優惠，晶片種類請選擇：[優良晶片/新進教師優惠](#))

STEP 2：查看申請須知與說明。

STEP 1 → STEP 2：查看申請須知與說明 → STEP 3 → STEP 4 → STEP 5 → STEP 6

財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心
前瞻性晶片製作申請須知與說明
(含部分負擔、速審部份負擔、新進教師優惠、優良晶片優惠)
公佈時間：109年01月02日

歡迎參閱「台灣半導體研究中心」前瞻性晶片製作申請須知與說明；本須知與說明內容涵蓋部分負擔、速審部份負擔、新進教師優惠、優良晶片優惠等類型之晶片，統稱為前瞻性晶片。
新進教師優惠、優良晶片優惠等晶片製作之計費與額度相關說明請參考第八項計費說明；請使用者於申請晶片製作時選擇正確之晶片類型，以避免發生計費相關的問題。
晶片製作相關訊息公佈於[本中心首頁>最新公告](#)，敬請參閱。

一、晶片製作申請資格：
國內學術界各大專院校教師經由本中心取得製程技術資料使用資格後，教師或所指導之學生即可提出相關的晶片製作申請。

二、程技術資料與晶片製作申請方法：
1. 請使用者先成為本中心之會員：

請詳細閱覽本須知與說明後，再按確定。

STEP 3 : 申請表填寫。

STEP 1 → STEP 2 → STEP 3 : 申請表填寫 → STEP 4 → STEP 5 → STEP 6

●填寫申請者資料:

申請者/設計者 : 學生一	學校 : 國立交通大學	系所 : 電子工程系(所)
*身分 : <input type="text" value="碩士"/>	申請者/設計者email : s1.cicctest@gmail.com	
連絡電話 : 035773693	手機 : <input type="text"/>	

指導教授 : 甲老師	學校 : 國立交通大學	系所 : 電子工程系(所)
連絡電話 :	指導教授email : p1.cicctest@gmail.com	

共同指導教授 :

姓名	學校	系所	連絡電話	共同指導教授email
----	----	----	------	-------------

共同設計者 :

姓名	學校	系所	連絡電話	共同設計者email
----	----	----	------	------------

●填寫晶片資料

使用製程 : T18	申請梯次 : 107A	申請種類 : 前瞻部分負擔
科技部計畫編號 : <input type="text"/>	計畫期間 : <input type="text"/>	領域別 : <input type="text"/>
計畫名稱 : <input type="text"/>		
*專題名稱(中文) : <input type="text"/>		
*專題名稱(英文) : <input type="text"/>		
*設計電路所屬類別 : <input type="checkbox"/> Analog <input type="checkbox"/> Digital <input type="checkbox"/> MEMS <input type="checkbox"/> RF		
晶片包裝: <input type="text" value="否"/>		
審查方式 : <input type="text" value="書面審"/> 使用TN40G、TN28HPM、AISOC、TN16FFC製程，除優良晶片優惠免審外，其餘全部參加審查會，選擇時請留意! 請選擇"參加審查會"的設計者留意。為維持審查會之公平，敬請出席審查會報告的設計者於審查會場配合完成身分確認作業；請出席審查會的設計者攜帶兩張附有照片之個人證件，其中一張用於換證進入本中心大樓，另一張用於報告前與會場工作人員進行身分確認。		
是否同意設計內容由審查委員攜走: <input type="text" value="同意"/>		
製程特殊選項 : <input type="checkbox"/> 使用ARM7TDMI CPU Core <input type="checkbox"/> 使用ARM926EJ CPU Core <input type="checkbox"/> 使用Cell-Based Design Kit(TSMC/ARM) <input type="checkbox"/> 使用MEMS18(使用CIC的後製程),需去除光阻(DieSort:8EA) <input type="checkbox"/> 使用MEMS18(後製程自行處理)		
*Top cell name : <input type="text"/>		
搭配整合製程選擇 : NONE		

填寫下線申請表相關資訊後，請按確

◎注意， 前有*的欄位為必填資訊

STEP 3：申請表填寫完成畫面之一。

申請表填寫完成訊息			
此筆晶片製作申請之案件編號為：T18-109B-A0003			
填表完成			
若您要進行下一步，STEP 4:上傳檔案請按此	STEP 4 上傳檔案 按鈕		
<input type="button" value="繼續申請下一顆"/>	<input type="button" value="檢視申請表"/>	<input type="button" value="進行申請表修改"/>	<input type="button" value="回申請總表"/>

◎若您符合申請資格，即出現本畫面告知您填表完成，您可以按STEP 4:上傳檔案按鈕繼續以下流程

STEP 3：申請表填寫完成畫面之二。

申請表修改完成訊息		
修改完成，但有一些條件不符合，請儘快確認！		
◎ 申請者:學生— 您的指導教授 / 授課教授尚未繳交本年度之智慧財產權切結書，因此請於離開本網頁後立刻通知您的教授進行智慧財產權切結書之簽名與用印，並請儘快將本年度之智慧財產權切結書的掃描檔利用E-Mail寄達 cisd_prouser@narlabs.org.tw 。若您有相關問題，請聯絡本中心晶片實作組：E-Mail: cisd_prouser@narlabs.org.tw 。		
若您要進行下一步上傳檔案請按此	STEP 4 上傳檔案 按鈕	
<input type="button" value="檢視申請表"/>	<input type="button" value="進行申請表修改"/>	<input type="button" value="回申請總表"/>

◎若您此筆申請案尚未符合申請資格，即出現本畫面上的說明原因，請儘快依說明內容進行資格確認，不過您仍可點選STEP 4:上傳檔案按鈕繼續以下流程

STEP 4：檔案上傳。

STEP 1 → STEP 2 → STEP 3 → STEP 4: 檔案上傳 → STEP 5 → STEP 6

製程名稱：TSMC 0.18 UM CMOS Mixed Signal RF General Purpose MiM Al 1P6M 1.8&3.3V
 梯次編號與申請種類：109B - 前瞻部分負擔
 晶片種類：CMOS
 申請編號：T18-109B-A0003

說明:
Step 4-1:點選上傳檔案，開啟上傳檔案視窗，上傳設計資料等所需檔案。
Step 4-2:倘若您完成上述所需完成的事項時，請點選[STEP 5:佈局圖檔資訊](#)，確認AutoDRC執行結果是否無誤(* SL類製程下線申請因不需要上傳佈局圖檔，可忽略STEP5，於檔案上傳完成後，請點選[STEP6:確認送出](#)，即完成申請)。

注意事項:
 1、僅使用GIPD製程，或僅有MEMS結構而無法進行LVS驗證者不需要上傳LVS驗證結果檔。若需要傳送多個DRC驗證結果檔，如：搭配T18(或TN90GUTM)整合製程之GIPD製程需傳T18-DRC(或TN90GUTM-DRC)與GIPD-DRC，其餘製程依照不同製程需上傳DRC, Antenna DRC, Wire Bond DRC,.....等，請使用文字編輯器將數個驗證結果檔的文字內容複製到同一個純文字檔案中，再進行上傳，請留意副檔名需為.drc.summary或.rep。若對於上傳檔案有疑問，請參考[範例說明](#)。
 2、自費晶片須上傳檔案包括：
 a. 佈局圖檔(GDS File)
 b. 設計內容(僅需佈局圖或打線圖)
 c. DRC結果(若為P15、GaN25、WIPD無需繳交)
 d. TRF文件(僅Cell-Based 設計案需傳交)
 3.若為SL類製程申請者，僅需上傳"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"
 4.若為P15、GaN25、WIPD申請者，僅需上傳"佈局圖檔"、"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"
 5.若您於本中心的EDA Cloud內進行晶片設計，請於EDA Cloud內開啟瀏覽器，輸入網址<http://ecbs.cic.org.tw/ecbs>，完成登入程序並選擇正確的案件後，上傳"佈局圖檔"、"DRC結果"與"LVS結果"檔案。

Step 4-1: 點選上傳檔案，開啟上傳檔案視窗，上傳設計資料等所需檔案。

上傳檔案列表：

檔案類型	格式說明	檔案名稱	上傳時間	檔案大小(kb)	檔案是否已上傳	上傳檔案
佈局圖檔	佈局圖檔(*.gds或*.db)	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	
設計內容	設定內容格式(*.doc、*.docx或*.docm)	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	<input type="button" value="上傳檔案"/>
DRC結果	DRC結果檔格式(*.drc.summary或*.rep)	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	
LVS結果	LVS結果檔格式(*.lvs.report或*.rep)	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	
TRF	上傳TRF文件檔	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	<input type="button" value="上傳檔案"/>

Step 4-2: 倘若您完成上述 4-1 所需完成的事項時，請點選[STEP 5:佈局圖檔資訊](#)，確認AutoDRC執行結果是否正確，確定申請資料及檔案皆已備妥，請點選[STEP 6:確認送出](#)，即完成申請)。

[點此可回到申請總表](#)

上傳檔案完成後，可點選STEP 5:佈局圖檔資訊，確認AutoDRC 執行

STEP 4：點選上傳檔案按鈕，開始檔案上傳畫面。

製程名稱：TSMC 0.18 UM CMOS Mixed Signal RF General Purpose MiM A1 1P6M 1.8&3.3V
梯次編號與申請種類：107A - 前瞻部分負擔
晶片種類：CMOS
申請編號：T18-107A-A0002

【注意事項】	1.請勿使用中文或含有空白及特殊字元為檔案名稱,否則會造成不能順利下載
	2.上傳前請確認所使用的DRC驗證檔是否為最新版本
	3.若為SL類製程申請者,僅需上傳"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"
	4.若為自費晶片,設計內容請上傳自費晶片之"佈局圖"或"打線圖";自費晶片僅Cell-Based 設計案需傳交"TRF文件檔"
	5.若為P15、GaN25、WIPD申請者,僅需上傳"佈局圖檔"、"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"。
	6.若您的"佈局圖檔"的檔案大小超過2.0GB以上時,請您與本中心晶片實作組窗口聯絡(電話:03-5773693 分機:7132 email:tsri-service@narlabs.org.tw),我們將為您處理,謝謝。

上傳檔案類型：

已上傳佈局圖檔	NONE	上傳進度:%
檔案連結	<input type="button" value="上傳"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>	


請依說明，按**瀏覽**，選擇要上傳

STEP 4：檔案上傳中畫面。

製程名稱：TSMC 0.18 UM CMOS Mixed Signal RF General Purpose MiM A1 1P6M 1.8&3.3V
梯次編號與申請種類：107A - 前瞻部分負擔
晶片種類：CMOS
申請編號：T18-107A-A0002

【注意事項】	1.請勿使用中文或含有空白及特殊字元為檔案名稱,否則會造成不能順利下載
	2.上傳前請確認所使用的DRC驗證檔是否為最新版本
	3.若為SL類製程申請者,僅需上傳"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"
	4.若為自費晶片,設計內容請上傳自費晶片之"佈局圖"或"打線圖";自費晶片僅Cell-Based 設計案需傳交"TRF文件檔"
	5.若為P15、GaN25、WIPD申請者,僅需上傳"佈局圖檔"、"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"。
	6.若您的"佈局圖檔"的檔案大小超過2.0GB以上時,請您與本中心晶片實作組窗口聯絡(電話:03-5773693 分機:7132 email:tsri-service@narlabs.org.tw),我們將為您處理,謝謝。

上傳檔案類型：

已上傳佈局圖檔	NONE	上傳進度:33%
檔案連結	<input type="button" value="上傳"/> <input type="button" value="處理中..."/> <input type="button" value="瀏覽..."/>	上傳中，請稍候 

頁面上會顯示上傳進度

STEP 4：檔案上傳完成提示畫面。

製程名稱：TSMC 0.18 UM CMOS Mixed Signal RF General Purpose MiM A1 1P6M 1.8&3.3V
 梯次編號與申請種類：107A - 前瞻部分負擔
 晶片種類：CMOS
 申請編號：T18-107A-A0002

上傳完成後，會提示您可檢視佈局圖檔資訊，確認AutoDRC 執行結

【注意事項】

- 1.請勿使用中文或含有空白及特殊字元為檔案名稱,否則會造成不能順利
- 2.上傳前請確認所使用的DRC驗證檔是否為最新版本
- 3.若為SL類製程申請者，僅需上傳"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"
- 4.若為自費晶片，設計內容請上傳自費晶片之"佈局圖"或"打線圖"；自費晶片僅Cell-Based 設計案需傳交"TRF文件檔"
- 5.若為P15、GaN25、WIPD申請者，僅需上傳"佈局圖檔"、"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"。
- 6.若您的"佈局圖檔"的檔案大小超過2.0GB以上時，請您與本中心晶片實作經窗口聯絡(電話:03-5773693 分機:7132 email:tsri-service@narlabs.org.tw)，我們將為您處理，謝謝。

網頁訊息

佈局圖檔已上傳完成，請記得至STEP 5:佈局圖檔資訊檢視檔案狀況

設計案需傳交"TRF文件檔"

03-5773693 分機:7132

上傳檔案類型：

已上傳佈局圖檔 T1.db@2020/08/06 15:15:36 上傳進度:100%

檔案連結 上傳中，請稍候

STEP 4：檔案上傳完成頁面。

製程名稱：TSMC 0.18 UM CMOS Mixed Signal RF General Purpose MiM A1 1P6M 1.8&3.3V
 梯次編號與申請種類：107A - 前瞻部分負擔
 晶片種類：CMOS
 申請編號：T18-107A-A0002

【注意事項】

- 1.請勿使用中文或含有空白及特殊字元為檔案名稱,否則會造成不能順利下載
- 2.上傳前請確認所使用的DRC驗證檔是否為最新版本
- 3.若為SL類製程申請者，僅需上傳"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"
- 4.若為自費晶片，設計內容請上傳自費晶片之"佈局圖"或"打線圖"；自費晶片僅Cell-Based 設計案需傳交"TRF文件檔"
- 5.若為P15、GaN25、WIPD申請者，僅需上傳"佈局圖檔"、"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"。
- 6.若您的"佈局圖檔"的檔案大小超過2.0GB以上時，請您與本中心晶片實作經窗口聯絡(電話:03-5773693 分機:7132 email:tsri-service@narlabs.org.tw)，我們將為您處理，謝謝。

上傳檔案類型：

已上傳佈局圖檔 T1.db@2020/08/06 15:15:36 上傳進度:100%

檔案連結 上傳檔案完成！
 檔案名稱：T1.db
 檔案大小：88306.536(kb)

上傳完成後，會告知您檔案名稱及大

☆若申請類型為CellBased 晶片，尚需做Cell Library 相關設定，請依照上傳

頁面上的說明，按步驟一步步做設定及上傳。

STEP 4 : Cellbased 晶片檔案上傳頁面Part 1 :

STEP 1 → STEP 2 → STEP 3 → STEP 4:檔案上傳 → STEP 5 → STEP 6
製程名稱：TSMC 0.18 UM CMOS Mixed Signal RF General Purpose MiM Al 1P6M 1.8&3.3V 梯次編號與申請種類：109B - 前瞻部分負擔 晶片種類：CMOS-CellBased 申請編號：T18-109B-A0003
<p>說明:</p> <p>Step 4-1: 請填寫Cell Library相關設定。</p> <p>Step 4-2: 點選上傳檔案，開啟上傳檔案視窗，上傳設計資料等所需檔案。</p> <p>Step 4-3: 檢查並確認上述填寫的設定已正確後，再按“完成上傳” 按鈕，即完成本晶片檔案上傳。</p> <p>Step 4-4: 倘若您完成上述4-1 ~ 4-3所需完成的事項時，請點選STEP 5:佈局圖檔資訊，確認AutoDRC執行結果是否無誤(*SL類製程下線申請因不需要上傳佈局圖檔，可忽略STEP5，於檔案上傳完成後，請點選STEP 6:確認送出，即完成申請)。</p> <p>注意事項:</p> <ol style="list-style-type: none">1、Step 4-1的設定或Step 4-2的上傳若有做任何異動或更新，請務必再按一次Step 4-3的“完成上傳” 按鈕。2、僅使用GIPD製程，或僅有MEMS結構而無法進行LVS驗證者不需要上傳LVS驗證結果檔。若需要傳送多個DRC驗證結果檔，如：搭配T18(或TN90GUTM)整合製程之GIPD製程需傳T18-DRC(或TN90GUTM-DRC)與GIPD-DRC，其餘製程依照不同製程需上傳DRC, Antenna DRC, Wire Bond DRC,.....等，請使用文字編輯器將數個驗證結果檔的文字內容複製到同一個純文字檔案中，再進行上傳，請留意副檔名需為.drc.summary或.rep。若對於上傳檔案有疑問，請參考範例說明。3、自費晶片須上傳檔案包括：<ol style="list-style-type: none">a. 佈局圖檔(GDS File)b. 設計內容(僅需佈局圖或打線圖)c. DRC結果(若為P15、GaN25、WIPD無需繳交)d. TRF文件(僅Cell-Based 設計案需傳交)4.若為SL類製程申請者，僅需上傳"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"5.若為P15、GaN25、WIPD申請者，僅需上傳"佈局圖檔"、"設計內容電子檔"與"TRF文件檔"6.若您於本中心的EDA Cloud內進行晶片設計，請於EDA Cloud內開啟瀏覽器，輸入網址http://ecbs.cic.org.tw/ecbs，完成登入程序並選擇正確的案件後，上傳"佈局圖檔"、"DRC結果"與"LVS結果"檔案。

STEP 4 : Cellbased 晶片檔案上傳頁面Part 2 :

Step 4-1: 設定Cell Library 相關選項

Step 4-1-1:設定本製程可選用的Core Cell: 🗑

Cell Library 未選擇		Cell Library 已選擇
T18_core cell	 	

Step 4-1-2:設定本製程可選用的IO Cell: 🗑

IO Library 未選擇		IO Library 已選擇
T18_IO cell	 	

Step 4-1-3:設定本製程可選用的IP: 🗑

IP 未選擇		IP 已選擇

Step 4-1-4:設定本製程可選用的RAM/ROM:(建議在UNIX或LINUX工作站以vi編輯器編輯產生ROM code, 否則產生ROM的時候可能會有問題發生) 🗑

RAM/ROM Type	Spec File	ROM code(rom only)	上傳	刪除
t18ra1shd ▼	瀏覽...	瀏覽...	上傳	

Step 4-1-5:設定本晶片是否由本中心加上Tag Cell/DummyCell: 🗑

addTagCell addDummyCell

STEP 4 : Cellbased 晶片檔案上傳頁面Part 3 :

Step 4-2: 點選上傳檔案，開啟上傳檔案視窗，上傳設計資料等所需檔案。

上傳檔案列表：

檔案類型	格式說明	檔案名稱	上傳時間	檔案大小(kb)	檔案是否已上傳	上傳檔案
佈局圖檔	佈局圖檔(*.gds或*.db)	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	
設計內容	設定內容格式(*.doc、*.docx或*.docm)	design.docx	2020/08/06 14:49:57	12.855	已上傳檔案	<input type="button" value="上傳檔案"/>
DRC結果	DRC結果檔格式(*.drc.summary或*.rep)	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	
LVS結果	LVS結果檔格式(*.lvs.report或*.rep)	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	
TRF文件	上傳TRF文件檔(TRF.doc、TRF.docx、TRF.docm、trf.doc、trf.docx或trf.docm)	NONE	NONE	NONE	尚未上傳檔案	<input type="button" value="上傳檔案"/>

上傳完成後，請記得按**完成上傳**按

Step 4-3: 檢查並確認上述填寫的設定已正確後，再按“完成上傳”，即完成本晶片上傳 -->

Step 4-4: 倘若您完成上述 4-1 ~ 4-3所需完成的事項時，請點選[STEP 5:佈局圖檔資訊](#)，確認AutoDRC執行結果是否正確，確定申請資料及檔案皆已備妥，請點選[STEP 6:確認送出](#)，即完成申請)。

STEP 5：檢視佈局圖檔資訊。

STEP 1 → STEP 2 → STEP 3 → STEP 4 → STEP 5:佈局圖檔資訊 → STEP 6

製程名稱：TSMC 0.18 UM CMOS Image Sensor Mixed Signal based General Purpose with 4T Standard Process USG AI 1P6M 1.8&3.3V

梯次與申請種類：103T,前瞻部分負擔

晶片種類：CMOS

申請編號：T18CIS4T-103T-A0001

佈局圖檔資訊：

DRC執行狀態	處理完成		
Top Cell Name	test1	左下右上座標	X1Y1(0.000,0.000);X2Y2(2000.000,2000.000)
使用層列表	13 15 16 17 18 19 27 28 29 31		
DRC結果下載	若您於本中心的EDA Cloud內進行晶片設計，請於EDA Cloud內開啟瀏覽器，輸入網址 http://ecbs.cic.org.tw/ecbs ，完成登入程序並選擇正確的案件後，再點選該案件的佈局圖檔資訊按鈕，下載DRC結果	各製程可違反之設計規範驗證(DRC)說明網頁	
提示訊息	*您在下線申請表所填寫的TopCellName為 123，系統檢查佈局圖檔得到的TopCellName為 test1，兩者不一致!請重新傳送正確的佈局圖檔或回到申請表進行修改TopCellName名稱		

注意事項：

- 1、佈局圖檔上傳完成後可至“[DRC及Queue執行狀態查詢](#)”網頁查詢DRC執行狀態。
- 2、P15、GaN25、WIPD製程注意事項：因P15、GaN25、WIPD製程無Calibre DRC，故無線上檢查DRC，DRC結果下載並無內容。
- 3、若您已確認申請資料及佈局圖檔無誤且尚未執行“確認送出”，請點選[STEP 6:確認送出](#)，即完成申請；若目前本案件處理流程已非申請中則不需要點選Step 6確認送出。
- 4、若DRC執行狀態為分析佈局圖檔錯誤時，請來信至:tsri-cbs@narlabs.org.tw通知系統管理員為您處理。
- 5、可點選本頁面下方的“重新查詢”按鈕取得即時的佈局圖檔檢查結果資訊。

[重新查詢](#) [回申請總表](#)

您可點選本頁面下方的[重新查詢](#)，得到本申請案最即時的DRC 執行狀態;若都正確，您可以點選[Step 6:確認送出連結](#)，進行下一步驟，或回申請總表再修改

Step 6：確認送出申請。

STEP 1 → STEP 2 → STEP 3 → STEP 4 → STEP 5 → STEP 6: 確認送出			
財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心 晶片製作申請表			
申請日期: 109年08月06日			
申請者資料	身分: 碩士		
	指導教授: 甲老師	指導教授學校: 國立交通大學	指導教授系所: 電子工程系(所)
	指導教授連絡電話:	指導教授email: p1.cicctest@gmail.com	
	申請者/設計者: 學生一	學校: 國立交通大學	系所: 電子工程系(所)
	連絡電話: 035773693	申請者/設計者email: s1.cicctest@gmail.com	
晶片資料	使用製程: T18	申請梯次: 107A	申請種類: 前繪部分負擔
	專題名稱(中文): test		
	專題名稱(英文): test		
	設計電路所屬類別: Analog	審查方式: 書面審	
	申請編號: T18-107A-A0002		
	晶片包裝: 否	包裝形式:	包裝顆數:
	是否同意設計內容由審查委員確認: 是		
Top cell name: t1			
計畫資料	計畫編號:	計畫期間:	領域別:
	計畫名稱:		
特殊選項			

上傳檔案列表：

檔案類型	格式說明	檔案名稱	上傳時間	檔案大小(kb)	檔案是否已上傳
佈局圖檔	佈局圖檔(*.gds或*.db)	T1.db	2020/08/06 15:23:47	88306.536	已上傳檔案
設計內容	設定內容格式(*.doc、*.docx或*.docm)	CIC-T1.doc	2020/08/06 15:27:58	186.368	已上傳檔案
DRC結果	DRC結果檔格式(*.drc.summary)	T1.drc.summary	2020/08/06 15:28:27	31.033	已上傳檔案
LVS結果	LVS結果檔格式(*.lvs.report)	T2.lvs.report	2020/08/06 15:28:36	10.273	已上傳檔案
TRF文件	TRF文件檔格式(TRF.doc、TRF.docx、TRF.docm、trf.doc、trf.docx或trf.docm)	TRF.doc	2020/08/06 15:28:44	97.28	已上傳檔案

確認送出

若您確認申請表及上傳檔案皆無誤，請按確認送出鈕；如尚未確認，或需要再修改申請表內容及上傳檔案，請回申請總表，點選本案件進行修改

若確認申請表內容，上傳檔案以及佈局檔資訊皆正確，您可按下本頁面最下方的**確認送出**按鈕，即完成送出本案的申請！

Step 6：確認送出申請：按下「確認送出」鈕時的確認畫面。

上傳檔案列表：

檔案類型	格式說明	檔案名稱	上傳時間	檔案大小(kb)	檔案是否已上傳
佈局圖檔	佈局圖檔(*.gds或*.db)	T1.db	2020/08/06 15:23:47	88306.536	已上傳檔案
設計內容	設定內容格式(*.doc、*.docx或*.docm)	CIC-T1.doc	2020/08/06 15:27:58	186.368	已上傳檔案
DRC結果	DRC結果檔格式(*.drc.summary)	T1.drc.summary		31.033	已上傳檔案
LVS結果	LVS結果檔格式(*.lvs.report)	T2.lvs.report		10.273	已上傳檔案
TRF文件	TRF文件檔格式(TRF.doc、TRF.docx、TRF.docm、trf.doc、trf.docx或trf.docm)	TRF.doc	15:28:44	97.28	已上傳檔案

網頁訊息

是否確認送出?

確認送出

若您確認申請表及上傳檔案皆無誤，請按確認送出鈕;如尚未確認，或需要再修改申請表內容及上傳檔案，請回申請總表，點選本案件進行修改

STEP 6 確認送出申請：按下「是否確認送出」的確定，系統再次向您確認。

上傳檔案列表：

檔案類型	格式說明	檔案名稱	上傳時間	檔案大小(kb)	檔案是否已上傳
佈局圖檔	佈局圖檔(*.gds或*.db)	T1.db	2020/08/06 15:23:47	88306.536	已上傳檔案
設計內容	設定內容格式(*.doc、*.docx或*.docm)	CIC-T1.doc	2020/08/06 15:27:58	186.368	已上傳檔案
DRC結果	DRC結果檔格式(*.drc.summary)	T1.drc.s			已上傳檔案
LVS結果	LVS結果檔格式(*.lvs.report)	T2.lvs.r			已上傳檔案
TRF文件	TRF文件檔格式(TRF.doc、TRF.docx、TRF.docm、trf.doc、trf.docx或trf.docm)	TRF.doc	15:28:44		已上傳檔案

網頁訊息

提醒您，一旦送出後，就無法再進行申請表修改及檔案上傳!
是否確認送出?

確認送出

若您確認申請表及上傳檔案皆無誤，請按確認送出鈕;如尚未確認，或需要再修改申請表內容及上傳檔案，請回申請總表，點選本案件進行修改

STEP 6 確認送出 - 按下「確認送出」鈕時，若申請資格尚未符合的顯示畫面。

STEP 1 → STEP 2 → STEP 3 → STEP 4 → STEP 5 → STEP 6: 確認送出

財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心
晶片製作申請表

08月06日

◎請儘快依說明內容進行資格確認或上傳所需檔案

申請者資料	身分: 碩士	指導教授: 甲老師	指導教授學校: 國立交通大學	指導教授系所: 電子工程系(所)
	指導教授連絡電話:			
	申請者/設計者: 學生一			
	連絡電話: 035773693			
晶片資料	使用製程: T18			
	專題名稱(中文): TEST			
	專題名稱(英文): TEST			
	設計電路所屬類別: Analog			
	申請編號: T18-109B-A0003			
	晶片包裝: 否			
	是否同意設計內容由審查委員攜走: 是			
計畫	計畫編號: 109	計畫期間: 08	領域別: TEST	

網頁訊息

尚有條件不符合:

- 申請者: 學生一 您有1篇逾期未繳的測試報告(下線申請編號: D35-108A-R0006), 因此請於離開本網頁後立刻進行測試報告繳交, 並請於下線申請截止前完成測試報告之繳交, 若您有測試報告相關問題, 請聯絡余小姐: E-Mail: hlyu@narlabs.org.tw

下列檔案尚未上傳:
佈局圖檔
TRF文件

確定

STEP 6 確認送出 - 成功訊息

上傳檔案列表:

檔案類型	格式說明	檔案名稱	上傳時間	檔案大小(kb)	檔案是否已上傳
佈局圖檔	佈局圖檔(*.gds或*.db)	T1.db	2020/08/06 15:23:47	88306.536	已上傳檔案
設計內容	設定內容格式(*.doc、*.docx或*.docm)	CIC-T1.doc	2020/08/06 15:27:58	186.368	已上傳檔案
DRC結果	DRC結果檔格式(*.drc.summary)	T1.drc.summary		31.033	已上傳檔案
LVS結果	LVS結果檔格式(*.lvs.report)	T2.lvs.report		10.273	已上傳檔案
TRF文件	TRF文件檔格式(TRF.doc、TRF.docx、TRF.docm、trf.doc、trf.docx或trf.docm)	TRF.doc	15:28:44	97.28	已上傳檔案

網頁訊息

恭喜您成功完成下線申請!

確定

若各項條件皆已符合，系統會出現本訊息，恭喜您成功完成線上申

若您確認申請表及上傳檔案皆無誤，請按確認送出鈕;如尚未確認，或需要再修改申請表內容及上傳檔案，請回申請總表，點選本案件進行修改

確認送出 回申請總表

下線申請總表：

申請過程中，您隨時可以至下線申請總表(本系統首頁左下方有 " 檢視申請總表 " 按鈕；右側的相關連結中也有 " 下線申請總表 " 連結，都可連結至本頁面)查看您所申請的案件的各項資訊，包括檢視或修改申請表，檔案上傳，查看佈局圖檔資訊，以及審查會後可於本表上查看審查成績，及做審查意見回覆上傳等作業。

申請總表												
當自行取消案件或案件處理進度為無法受理、無法下線、結案等狀態時，該筆資料將移至下線歷史資料，請至該頁面查詢案件。												
												下線新申請
身份別	申請種類	申請編號	申請文件	檔案上傳	佈局圖檔資訊	確認送出	審查成績	審查意見回覆上傳	本中心處理資訊	處理進度	取消	
1	申請者	前瞻部分負擔	T18-109B-A0003	修改 檢視	上傳	資訊	送出				申請中	
2	申請者	前瞻部分負擔	T18-107A-A0002	檢視	檢視	資訊	送出				申請案件已送出	
3	共同設計者	前瞻速審部分負擔	D35-107A-R0001	檢視	檢視	資訊	送出				申請資格未符合	
4	填表人	自費晶片	T18-701B-S0007	修改 檢視	上傳	資訊	送出	N/A	N/A		申請中	
5	申請者	前瞻部分負擔	T18-701A-A0024	檢視	檢視	資訊				檢視	TSRI資料確認中	
6	填表人	自費晶片	T18-701A-S0022	檢視	檢視	資訊		N/A	N/A	檢視	TSRI資料確認中	
7	填表人	自費晶片	T18-701B-S0006	檢視	檢視	資訊		N/A	N/A	檢視	TSRI資料確認中	
8	申請者	前瞻部分負擔	TN16FFC-104T-A0002	檢視	檢視	資訊				檢視	TSRI資料確認中	
9	申請者	前瞻部分負擔	TN40G-105Z-A0005	檢視	檢視	資訊				檢視	TSRI資料確認中	
10	申請者	前瞻部分負擔	TN16FFC-104T-A0001	檢視	檢視	資訊		成績	檢視	檢視	TSRI處理中	

最前頁 1 下一頁 最後頁 每頁顯示 10 筆 共 64 筆資料

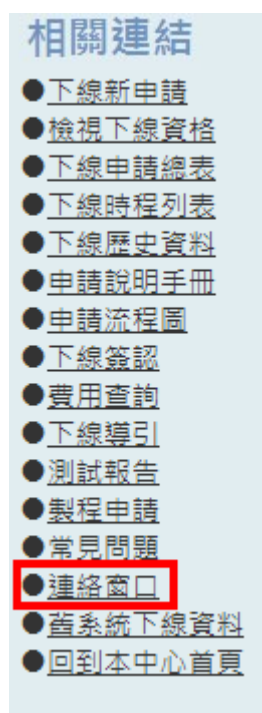
點選申請總表上的處理進度，會顯示目前本申請案的處理進度是到哪個步驟，

協助您了解您的申請案目前狀態，如下圖所示。



相關連結：

在右側的相關連結裡，列出所有與下線申請相關的連結；您可點選您所需要的資訊：如當您需要上傳測試報告時，請點選：測試報告；當您要查看下線導引時，請點選下線導引，以此類推。



☆如果對使用本系統有任何問題，您可點選[相關連結](#)➔ "[連絡窗口](#)" 查詢相關的業務負責人員聯絡方式，也歡迎進入「[客服諮詢](#)」，相關業務承辦人員將盡速與您聯繫。本中心將竭誠為您服務！